

深圳市亿道信息股份有限公司 关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司。
- 本次担保金额：公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司以其持有的深圳市亿封智芯封装科技有限公司 40% 股权为限，为中国建设银行股份有限公司深圳市分行向被担保人提供的固定资产贷款提供质押担保。
- 本次担保无反担保。
- 风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 67.40%；敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况暨关联交易概述

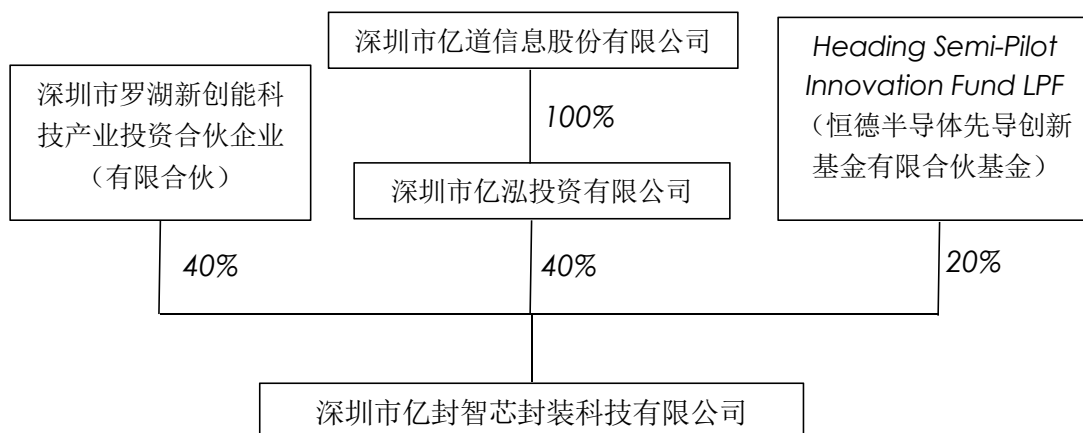
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“亿封智芯”或“债务人”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），申请固定资产贷款 3.75 亿元。为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业（有限合伙）、HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯 40% 股权为限为该笔贷款提供质押担保。

公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事张治宇、陈粮对本议案回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人（关联方）基本情况

- 1、企业名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司
- 2、成立日期：2025 年 10 月 27 日
- 3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3108。
- 4、法定代表人：韩松笑
- 5、注册资本：人民币 12,500 万元
- 6、经营范围：一般经营项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
- 7、股权结构：



亿封智芯无实际控制人。

8、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

9、主要财务数据：截至2025年12月31日，亿封智芯尚未实际运营，因此无财务数据。

10、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

11、因公司董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责人，亿封智芯为公司关联方。

三、股权质押合同的主要内容

截至目前，股权质押合同尚未签署，主要内容如下：

甲方1（出质人）：深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)

甲方2（出质人）：深圳市亿泓投资有限公司

甲方3（出质人）：HEADING SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）

乙方（质权人）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

1、质押权利：甲方1以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）、甲方2以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债务人的20%股权（出资额为人民币2500万元）共同设定质押。

2、质押期限：自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。

3、质押担保范围：甲方1以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）、甲方2以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债务人的20%股权（出资额为人民币2500万元）为限为主合同项下已实际提款的全部债务提供质押担保，且不超过甲方各自质押权利的最终价值。

主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

4、质押登记时间：本合同签订后壹拾伍个工作日内到相应的登记部门办妥质押登记手续。

5、质权的解除：质押权利担保的全部债务清偿后，质权人应及时与出质人共同办理质押登记注销。

6、生效条件：本合同经各方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次亿泓投资拟以其持有的亿封智芯 40%股权为限为该笔贷款提供质押担保，系银行审批贷款所需的必要条件。作为增信措施亿泓投资仅提供亿封智芯 40%股权的质押担保，无连带责任担保，且提供质押担保的股权资产价值有限，公司不会因本次担保行为受到重大影响，担保风险可控。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至本公告披露日，除本次担保外，公司与亿封智芯未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，一致审议通过了此项议案，独立董事认为：本次担保旨在满足参股公司生产经营的资金需求，提升其融资能力与经营效率，符合公司整体利益。亿封智芯作为公司参股公司，资信状况良好，偿债能力充足，且其他股东已按出资比例同步提供股权质押担保，风险总体可控。本次担保不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

七、董事会意见

董事会认为，本次担保主要系为满足参股公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次被担保对象亿封智芯为公司的参股公司，公司董事会认为其具备偿还债务的能力，且其他股东按出资比例提供相应的股权质押，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 138,908.60 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 67.40%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.43%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、固定资产贷款合同（未签署）；
- 3、权利质押合同（未签署）。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日